



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目：第三代半导体器件在数字能源领域的应用趋势与挑战

演讲人：侯召政 技术与平台规划部部长 华为数字能源技术有限公司

演讲摘要：

在低碳化、电气化、数字化、智能化的趋势下，能源世界和数字世界将深度融合发展，能源产业已经进入到数字能源新时代。围绕碳中和道路上的三大关键变革，华为致力于打造数字能源时代的三新能源基础设施，即：面向能源变革的新型电力系统能源基础设施、面向出行变革的新型电动出行能源基础设施、面向智能变革的新型数字产业能源基础设施。本报告将首先介绍华为数字能源“三新”系统发展趋势与面临的挑战，聚焦 4T (watt、heat、battery、bit) 技术并进行创新融合，推动能源行业绿色低碳化转型；再重点介绍化合物功率半导体器件/模组在数字能源领域的应用与挑战。

演讲大纲：

1. 全球能源革命及数字能源时代三新基础设施
2. 华为数字能源十大技术趋势
3. 化合物半导体特性及应用与挑战
4. 化合物半导体功率模组应用与挑战

适合对象：

演讲人简介：

侯召政，2007 年加入华为，曾主导数字控制芯片、功率封装、功率器件团队的创建，开发了多款 x 千万~x 亿 PCS 发货的产品；自 2022 年开始，担任华为数字能源技术与平台规划部长，主要负责新型电力系统、AI、储能等领域的技术三代技术的规划开发工作。同时担任 (ICEPT) 功率封装技术委员会委员、中国电源学会元器件专业委员会委员及多个高校的企业导师，拥有国内外专利 60+ 件。